



Regensburg - das mittelalterliche Wunder Deutschlands!

Lernen Sie das UNESCO Weltkulturerbe kennen und genießen Sie die bayerische Gastlichkeit.

**Hotel ACHAT Plaza
Herzog am Dom
Domplatz 3
93047 Regensburg**

Organisation

Seminarmanagement

Dipl.-Betriebsw. (FH)
Sabine Ziegau
OTTI, Seminare und Fachforen
Bereich Technik
Wernerwerkstraße 4
93049 Regensburg
Telefon +49 941 29688-32
sabine.ziegau@otti.de

Zimmerreservierung

Hotel ACHAT Plaza
Herzog am Dom
Telefon +49 941 58400-0
Sonderkonditionen für
OTTI-Seminar Teilnehmer!
www.achat-hotel.de
oder
Tourist-Information
Regensburg
Telefon +49 941 507-4412
www.regensburg.de

Teilnahmegebühren und Leistungen

Bei Anmeldung bis 20.07.2010:
Pro Person: € 890,00
Bei Anmeldung danach:
Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00
Unternehmen aus
Oberfranken, Nieder-
bayern und der
Oberpfalz: € 910,00

Der zweite Teilnehmer Ihrer
Firma erhält **10 % Ermäßigung**,
jeder weitere Teilnehmer Ihrer
Firma erhält **20% Ermäßigung**.

In der Teilnahmegebühr sind
Pausengetränke, zwei Mittag-
essen, eine Stadtführung, ein
Abendessen und ausführliche
Tagungsunterlagen (auch auf CD)
enthalten.

Ja, ich nehme teil am OTTI-Fachforum Kunststoffe in der Elektronik

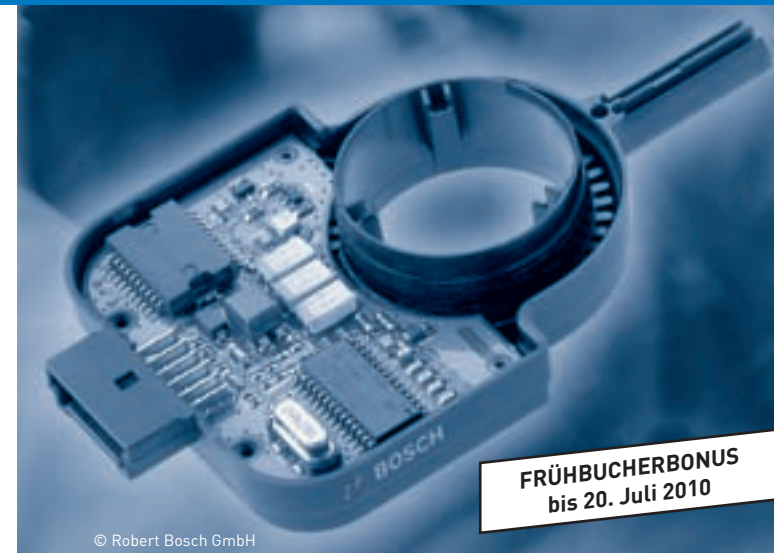
15. bis 16. September 2010 in Regensburg (KUT 3620)

Name	
Vorname	Titel
Telefon	Telefax
E-Mail	
Abteilung/Funktionsbereich	
Firma/Institution	
Straße/Postfach	
PLZ/Ort	
Rechnungsadresse (nur bei Abweichung von der Anmeldeadresse)	
Firma/Institution	
Straße/Postfach	
PLZ/Ort	
Branche	Zahl der Mitarbeiter
<input type="checkbox"/> Unternehmen aus Ostbayern	
OTTI-Kundennummer	USt-IdNr.
Datum	Unterschrift

**Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI),
Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg**

Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen. Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstaltungseinlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei OTTI eingegangen ist. Etwaige Änderungen aus dringendem Anlass behält sich OTTI vor. Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 bis 15 Tagen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 120,00. Bei späteren Absagen (ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. Für Sach- und Vermögensschäden, welche OTTI zu vertreten hat, haftet OTTI - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg.



**FRÜHBUCHERBONUS
bis 20. Juli 2010**

© Robert Bosch GmbH

Kunststoffe in der Elektronik

**Vom innovativen Werkstoff
zum multifunktionalen Bauteil**

15. bis 16. September 2010 in Regensburg

OTTI-plus

Wichtige Kontakte knüpfen, Inhalte diskutieren, zwanglos Netzwerke aufbauen - nutzen Sie dafür das OTTI-Rahmenprogramm. Ein Abendessen im Kreise der Teilnehmer und Referenten, eine Stadtführung oder eine Besichtigung bieten Ihnen Freiraum für das Vertiefen von Fachfragen und das Aufgreifen von innovativen Ideen.

V-J-2010-05-05 www.otti.de



OTTI  Training
Seminare
Tagungen

www.otti.de



© BASF SE

Fachforum



Kunststoffe in der Elektronik

15. bis 16. September 2010 in Regensburg

Alles, was Sie über Kunststoffe in der Elektronik wissen sollten:

- Eigenschaften von Kunststoffen
- Materialanforderungen
- Flammschutz & Additivierung
- Kunststoffverarbeitung in der Elektronik (Spritzguss, Klebtechnik, Metallisieren)
- 3D-MID
- Neue Trends & Innovationen auf dem Kunststoffsektor
- Anwendungsbeispiele aus Elektronik, Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik
- Polytronic

Über 200 Veranstaltungen auf www.otti.de

Expertenwissen für Ihren Erfolg – profitieren Sie von praxisrelevanten Informationen durch sorgfältig ausgewählte Referenten und den erprobten Qualifizierungskonzepten in den OTTI-Veranstaltungen. Informationen zu allen aktuellen Seminaren, Fachforen und Tagungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.otti.de

Programm

1. Tag, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Werkstoffe

1. Kunststoffe in der Elektronik – eine Übersicht

- Grundlagen der Kunststoff-Physik
 - Klassifizierung der Kunststoffe
 - Eigenschaften vom Commodity zum Hochleistungs-Kunststoff
 - Trends/Innovationen/ Neuentwicklungen
- Dr.-Ing. Carsten Weiß

2. Hochleistungsthermoplaste in der Elektronik

- Übersicht
 - Typische Anforderungen
 - Anwendungsbeispiele
- Dipl. Ing. Mark Völkel

3. Flammschutzrüstung von technischen Kunststoffen

- Flammschutzsysteme
 - Prüfungen
 - Moderne technische Lösungen für die Elektroindustrie
 - Aufgaben des Rohstoffherstellers
- Marc Ollig

4. Duroplaste in der Elektronik

- Übersicht Duroplaste
 - Spezielle Eigenschaften
 - Verarbeitungstechnik
 - Qualitätssicherung, Möglichkeiten und Grenzen
 - Anwendungsbeispiele
- Prof. Dr.-Ing. Michael Gehde

Verarbeitungsverfahren

5. Präzisionspritzguss in der Automobilelektronik

- Spritzgießverfahren
 - Spritzgießwerkzeug als Schlüssel zur Bauteilqualität
 - Absicherung des Prozesses
 - Bauteilbeispiele
- Dr.-Ing. Andreas Herold

6. Klebstoffe in der Elektronik

- Übersicht Klebstofftypen
 - Anforderungen an Klebverbindungen
 - Schnelle Prozesse
 - Prozesskontrolle
 - Anwendungsbeispiele
- Dr. Stefanie Wellmann

7. Metallisieren von Kunststoffen in der Elektronik

- Einsatzgebiete von Kunststoff in der Elektronik
 - Metallisierungsverfahren – Übersicht
 - Metallisierungsverfahren für spezielle Kunststoffe
 - Strukturierte Metallisierung
 - Anwendungsbeispiele und Ausblick
- Hans Ullrich Eckert

Stadtführung und gemeinsames Abendessen

2. Tag, 08:30 Uhr bis 15:50 Uhr

Innovationen - Trends in der Elektronik

1. 3-D MID – Quo Vadis?

- Bestandsaufnahme der MID-Technik

- Verfahrensvorstellung und Vergleiche
 - Markt und Trends
 - Realisierte Anwendungen
- Dr. Wolfgang John

2. Polymerfolien in der Elektrotechnik und Elektronik

- Einsatzgebiete
 - Folientypen
 - Eigenschaften und Eigenschaftsmodifikation
 - Entwicklungstrends
- Dr.-Ing. Christian Seidel

3. Micro-fabrication technologies for Organic Large Area Electronics (OLAE)

- Hybrid fabrication process for organic electronics
 - System integration on foil substrates
 - Selective large area structuration and nano
 - Nanotechnology in OLAE? (Vortrag auf Deutsch)
- Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Bock

4. Alterungsschutz von Kunststoff-Bauteilen

- Alterungsschutzmittel (Stabilisatoren)
 - Alterungsprozesse bei Hochpolymeren
 - Wirkungsmechanismen von Alterungsschutzmitteln
 - Prüfmethoden
 - Additive bzw. Additivsysteme für einzelne Kunststofftypen
 - Besondere Anforderungen
- Dr. Volker Schäfer

5. Kunststoffeneinsatz im Kraftfahrzeug-Bordnetz

- Das Nervensystem im Automobil
 - Werkstofffraktion im Bordnetz
 - Anforderungsprofile für Bordnetzkomponenten
 - Funktionaler Kunststoffeinsatz in ausgewählten Bordnetzkomponenten
- Dipl.-Ing. (FH) Georg Seitz

6. Kunststoffe für organische Substrate (Leiterplatten)

- Beispiele für Leiterplatten, Historie
 - Anforderungen an Basismaterial und Kennwerte
 - Materialien für allgemeine und spezielle Anwendungen
 - Sonstige Kunststoffe für und auf Leiterplatten
 - Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse
 - Entwicklungstrends und Ausblicke
- Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schilpp

7. Neuartige Flächenlichtquellen auf Basis von organischen Leuchtioden

- Funktionsweise und typischer Aufbau
 - Fertigungstechnische Aspekte
 - Alleinstellungsmerkmale von OLEDs
 - Technische Herausforderungen
 - OLEDs für Beleuchtungsanwendungen
- Dr.-Ing. Benjamin Krummacher

Ihre fachliche Leitung



Dr.-Ing. Carsten Weiß

Senior Manager, Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch GmbH, Waiblingen

Herr Dr. Weiß leitet das Themengebiet „Thermoplaste, Duroplaste und Verarbeitungstechnik“. Innerhalb seines Arbeitsbereiches werden sowohl Forschungs- und Vorentwicklungsprojekte als auch anwendungstechnische Fragestellungen auf dem Kunststoffsektor bearbeitet.

Herr Dr. Weiß ist Erfinder zahlreicher Patente auf dem Arbeitsgebiet Kunststoff, Gutachter der AIF sowie Autor des Fachbuches „Kunststoffe in der Elektronik“.

Ihre Referenten

Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Bock

Stellvertretender Institutsleiter, Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, München

Hans Ullrich Eckert

Product Manager, Enthone GmbH, Langenfeld

Prof. Dr.-Ing. Michael Gehde

Insitut für Fördertechnik und Kunststoffe, Leiter der Professur Kunststoffe, Technische Universität Chemnitz

Dr.-Ing. Andreas Herold

Abteilungsleiter Werkzeugbau, Robert Bosch GmbH, Waiblingen

Dr. Wolfgang John

Senior LPKF-LDS® Consultant, LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen

Dr.-Ing. Benjamin Krummacher

OLED Ligthing, Osram Opto Semiconductors, Regensburg

Marc Ollig

Produkt Manager, A. Schulman GmbH, Kerpen

Dr. Volker Schäfer

Geschäftsführender Gesellschafter, Schäfer-Additivsysteme GmbH, Ludwigshafen/Rhein

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schilpp

Productmanager, WÜRTH ELEKTRONIK GmbH & Co. KG, Niedernhall

Dr.-Ing. Christian Seidel

Projektleiter Polymer Films & Coatings, Siemens AG, Erlangen

Dipl.-Ing. (FH) Georg Seitz

Leiter der Entwicklung Leitungssatzkomponenten, Audi AG, Ingolstadt

Dipl. Ing. Mark Völkel

Technisches Marketing Ultrason, BASF SE, Ludwigshafen

Dr. Stefanie Wellmann

Geschäftsführende Gesellschafterin, Wellmann Technologies GmbH, Friedelsheim

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte, Ingenieure und Entwickler, die sich mit Kunststoffen in der Elektronik befassen
- Physiker, Chemiker und Materialwissenschaftler